

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 4 区分

【発行日】平成 26 年 2 月 27 日 (2014.2.27)

【公表番号】特表 2014-501185 (P2014-501185A)

【公表日】平成 26 年 1 月 20 日 (2014.1.20)

【年通号数】公開・登録公報 2014-003

【出願番号】特願 2013-543491 (P2013-543491)

【国際特許分類】

B 3 2 B 27/30 (2006.01)

B 6 5 D 85/86 (2006.01)

B 6 5 D 65/40 (2006.01)

【F I】

B 3 2 B 27/30 1 0 2

B 6 5 D 85/38 N

B 6 5 D 65/40 D

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 12 月 17 日 (2013.12.17)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電子素子をパッケージングするためのヒートシールフィルムであって、
ベース層と、

前記ベース層上に設けられる少なくとも 1 つの中間層であって、前記中間層の全重量を
100 重量%として、

5～70 重量%の酢酸ビニルコポリマーであって、酢酸ビニルに由来する単位がコポリ
マーの 10 モル%超を構成する酢酸ビニルコポリマーと、

20～90 重量%のスチレンブタジエンコポリマーと、

0～40 重量%の導電性ポリマーと、を含む、混合物を含む中間層と、

前記中間層の、前記ベース層とは反対側の表面に設けられる少なくとも 1 つのヒートシ
ール層と、を備えるヒートシールフィルム。

【請求項 2】

前記ヒートシール層が、ヒートシール層全体の全重量に対して 60%以下の含有率の導
電性充填剤を更に含む、請求項 1 に記載のヒートシールフィルム。

【請求項 3】

電子素子を備えるキャリアテープをヒートシールするためのカバーテープであって、
ベース層と、

電荷を消失させるためにベース層上に配置された中間層であって、前記中間層の全重量
を 100 重量%として、

5～70 重量%の酢酸ビニルコポリマーであって、酢酸ビニルに由来する単位がコポリ
マーの 10 モル%超を構成する酢酸ビニルコポリマーと、

20～90 重量%のスチレンブタジエンコポリマーと、

0～40 重量%の導電性ポリマーと、を含む、混合物を含む中間層と、

中間層上に配置されたヒートシール層と、

前記ベース層の、前記中間層とは反対側の表面に配置された、場合により設けられる帯

電防止コーティングと、を備え、

前記カバーテープの平均光透過率が少なくとも75%であり、光学的ヘイズ値が50%以下であり、表面抵抗率が 1×10^{11} 以下であることにより、前記カバーテープがキャリアテープにヒートシールされて物品を形成する際、前記キャリアテープに対する前記カバーテープの平均剥離強度が少なくとも20 gf/mm (196 N/m)であり、物品が50以上の温度及び90%以上の相対湿度に少なくとも5日間曝露された場合の剥離強度の低下が10%以下である、カバーテープ。